



HT6P20Drf433mhzAG116

SAW SMT SAW IC RF

	315Mhz / 433Mhz / 868Mhz / 250MHz480MHz
	±150KHz
	A.15272240HT6P20BHT6P20D
	2260,2262,2264,2272
	HCS301HCS300HCS200
	B.
	12 V
	12 mA
	50100
	AM / FM
OEMODM	
	1
	CE ROHS
	-50°C + 80°C
	LED

/









EXW

FCA FOB

CIF CFR

1111

2000RFID1
/
 COFTA F E ...
 EXW FOB FCT CIF CFR ...

□□□□5□□□□

[illegible]



Realese

K2B 86 * 86mm

Realese

K9A 115 * 40mm

NO /

NC K5B 86 * 86mm





1. 86mm * 86mm
 2. NO K4B 86 * 86mm
 3. HiHg Kirsite K14B 86 * 86mm
 4. K815B 86 * 86mm

1. 86mm * 86mm

1. 86mm * 86mm
2. 86mm * 86mm
3. OEM / ODM
4. 86mm * 86mm

5. 請說明以下各項之定義及用途：
1. 包裝設計：指為保護產品、方便運輸及儲存而設計之包裝。
2. 包裝材料：指用於包裝產品之材料，如紙箱、紙張、塑膠、金屬等。
3. 包裝結構：指包裝之內部結構，如隔板、填充物、捆綁帶等。
6. 包裝設計之主要考量因素有哪些？
7. 包裝設計之主要步驟有哪些？
8. 包裝設計之主要工具及設備有哪些？

包裝設計之主要工具及設備：

Q1. 包裝設計之主要工具及設備有哪些？

A. 包裝設計之主要工具及設備包括：包裝設計軟體、包裝設計模板、包裝設計圖紙、包裝設計模型、包裝設計樣品等。

Q2. 包裝設計之主要步驟有哪些？

A. 包裝設計之主要步驟包括：包裝設計需求分析、包裝設計方案制定、包裝設計圖紙繪製、包裝設計模型製作、包裝設計樣品製作、包裝設計測試與驗證等。

Q3. 包裝設計之主要考量因素有哪些？

A. 包裝設計之主要考量因素包括：產品特性、運輸環境、儲存環境、包裝成本、包裝效率、包裝環保等。

Q4. 包裝設計之主要工具及設備有哪些？

A. 包裝設計之主要工具及設備包括：包裝設計軟體、包裝設計模板、包裝設計圖紙、包裝設計模型、包裝設計樣品等。

Q5. 包裝設計之主要考量因素有哪些？

A. 包裝設計之主要考量因素包括：產品特性、運輸環境、儲存環境、包裝成本、包裝效率、包裝環保等。

Q6. 包裝設計之主要步驟有哪些？

A. 包裝設計之主要步驟包括：包裝設計需求分析、包裝設計方案制定、包裝設計圖紙繪製、包裝設計模型製作、包裝設計樣品製作、包裝設計測試與驗證等。